

課題番号 : F-15-FA-0039  
利用形態 : 機器利用  
利用課題名(日本語) : LED 評価基板のワイヤーボンディングとダイシング  
Program Title (English) : Assembly of LED Device  
利用者名(日本語) : 猿渡洋孝  
Username (English) : H. Sawatari  
所属名(日本語) : 三菱化学株式会社  
Affiliation (English) : Mitsubishi Chemical , Co.,Ltd.

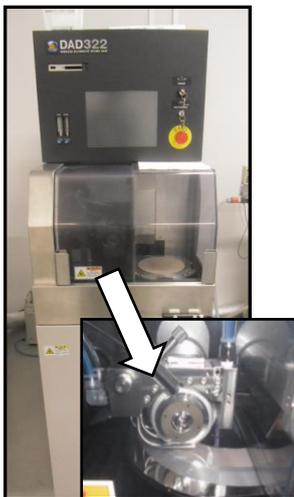
## 1. 概要(Summary)

LED チップを LED パッケージへと実装し、点灯 LED サンプルの作製を行った。

## 2. 実験(Experimental)

### 【利用した主な装置】

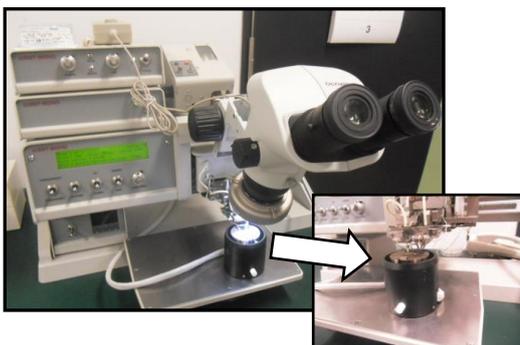
・ダイシングソー DAD322 DISCO



・エポキシダイボンダー MODEL 7200CR



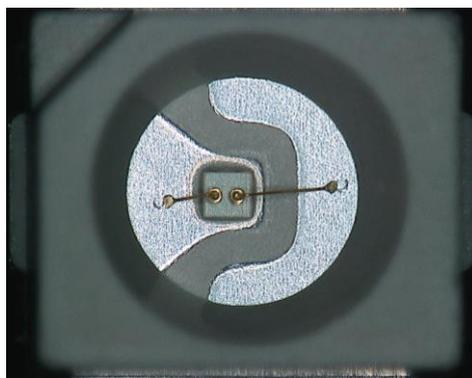
・ワイヤーボンダー MODEL 747677E



### 【実験方法】

ダイシングソーにより、ウェハから LED チップを切り出し、エポキシダイボンダー、ワイヤーボンダーにより、専用パッケージへとボンディングを実施し LED パッケージサンプルを作製した。

## 3. 結果と考察(Results and Discussion)



ダイシングソーにより、テスト成形サンプル等のカッティングを実施し、エポキシダイボンダー、ワイヤーボンダーにより、ダイボンド、ワイヤーボンディングを実施した。多様な LED 用パッケージの試作を実施し、正常動作を確認した。

## 4. その他・特記事項(Others)

なし。

## 5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

## 6. 関連特許(Patent)

なし。